



Kupferhartlot HARRIS 5 (L-Ag5P)

Eigenschaften

Kupfer-Phosphor-Legierung mit guten Kapillareigenschaften. Durch die Dünnpflüssigkeit werden hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erreicht. **HARRIS 5** verfügt über eine gute Benetzung, die für dichte und porenfreie Verbindungen sorgt.

Anwendungen

Für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis 150° C. Für Verbindungen von Kupfer mit Kupfer oder von Kupferlegierungen (Messing, Bronze, Rotguss) geeignet. Auf Flussmittel kann wegen des Phosphor-Gehaltes verzichtet werden. Für den Einsatz bei schwefelhaltigen Medien sowie für Verbindungen von Stählen (Fe) und Nickellegierungen ist dieses Lot nicht geeignet.

Kupferinstallationen: Elektroindustrie, Klimaanlagebau, Kühlanlagen, Wärmetauscher usw.

In der Kälteindustrie kann **HARRIS 5** bis zu Temperaturen von -60°C eingesetzt werden.

Zusammensetzung

Cu %	P %	Ag %	Andere %
Balance	5,7 – 6,3	4,5 – 5,5	0,25

Technische Daten

ISO 17672	CuP 281
DIN EN 1044:	CP 104
DIN 8513:	L-Ag5P
Arbeitstemperatur:	~ 740°C
Schmelzbereich:	645°C - 815°C
Zugfestigkeit nach DIN EN 12797:	250 N/mm ²
Dichte:	8,0 g/cm ³

Herstellungsform / Liefermöglichkeiten

Drähte 1,0 bis 3,0 mm (Bund oder Spule)

Stäbe, rund oder vierkant, blank 1,5 , 2,0 und 3,0 mm, Länge 500 mm (VPE 1 kg / 5 kg)

Ringe und Formteile nach Kundenspezifikation

Andere Formen, Abmessungen und Verpackungseinheiten auf Anfrage.

Arbeitssicherheit

Arbeitsplätze während des Lötens ausreichend lüften.

Zulassungen sowie weitere technische Informationen auf Anfrage.

Die Angaben über unsere Produkte, Geräte und Verfahren erfolgen unter dem Vorbehalt von Änderungen und Irrtümern. Für die Frage der Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeit unserer Produkte sind ausschließlich die konkreten geschlossenen Verträge maßgebend, aus unserer Werbung und technischen Informationen können keine vertraglich geschuldeten Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten hergeleitet werden.